

2011年3月期業績予想と 今後の基本方針

代表取締役社長 竹中 博司

2010年5月12日



東京エレクトロン

2010年3月期 レビュー



2010年3月期 業績予想と結果

(億円)

	2010年3月期		
	期初予想 (2009/5/14)	最終結果	差異
売上高	3,000	4,186	+1,186
営業利益	-630	-21	+609
経常利益	-610	25	+635
税前利益	-610	-77	+533
当期純利益	-380	-90	+290



2010年3月期 成果

短期対応

▶市場急変への対応

- ・前年比300億円の固定費削減達成

中期的視点

▶高水準な研究開発投資を実施

- ・研究開発費540億円(対SPE/FPD/PVE売上比 16%)
- ・既存SPE, RLSA, 3DI, SiCエピ, その他新規

▶次の飛躍に向けて、組織と拠点の再編・最適化を実行

- ・営業・サービス体制の再編
- ・国内開発・製造拠点の集約、及び台湾、米国のテクノロジーセンター設立と強化
- ・宮城新工場建設計画再開を決定
- ・社員へのワングレードアッププログラム実施



市場環境



今期の事業環境

▶ SPE設備投資

世界経済の回復に伴い、半導体需要が大幅に伸張し、受注環境が急回復
年後半から来年前半には新規ラインも数多く計画されており、前期に比べて
+90%以上の前工程投資が予想される

▶ FPD設備投資

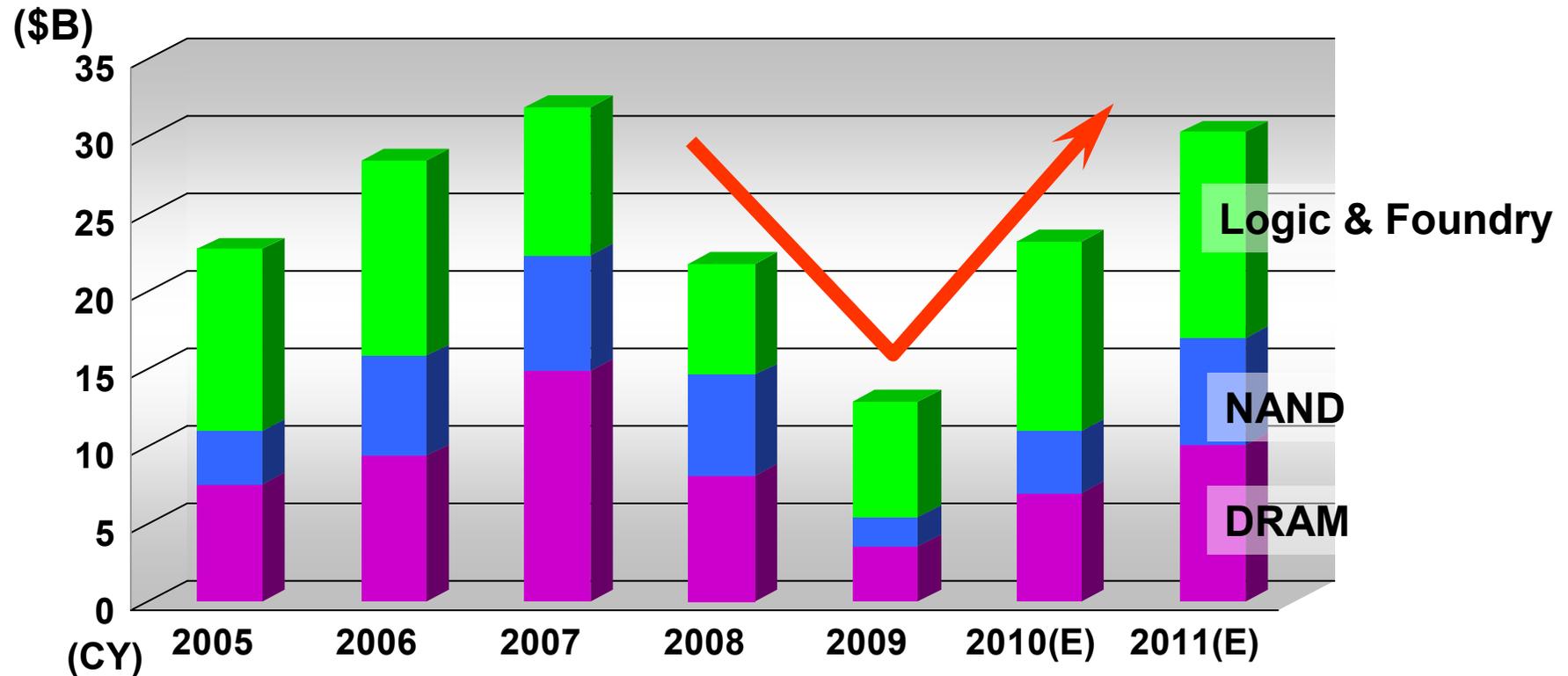
中国を中心として薄型TV需要は引き続き旺盛で、新規ライン建設投資が継続

▶ PV設備投資

価格優位性により、単結晶シリコン系や化合物(Cd-Te)系が好調
一方、薄膜シリコン系は伸び悩んでいるが、中・長期的には成長を期待



SPEセグメント別前工程投資額

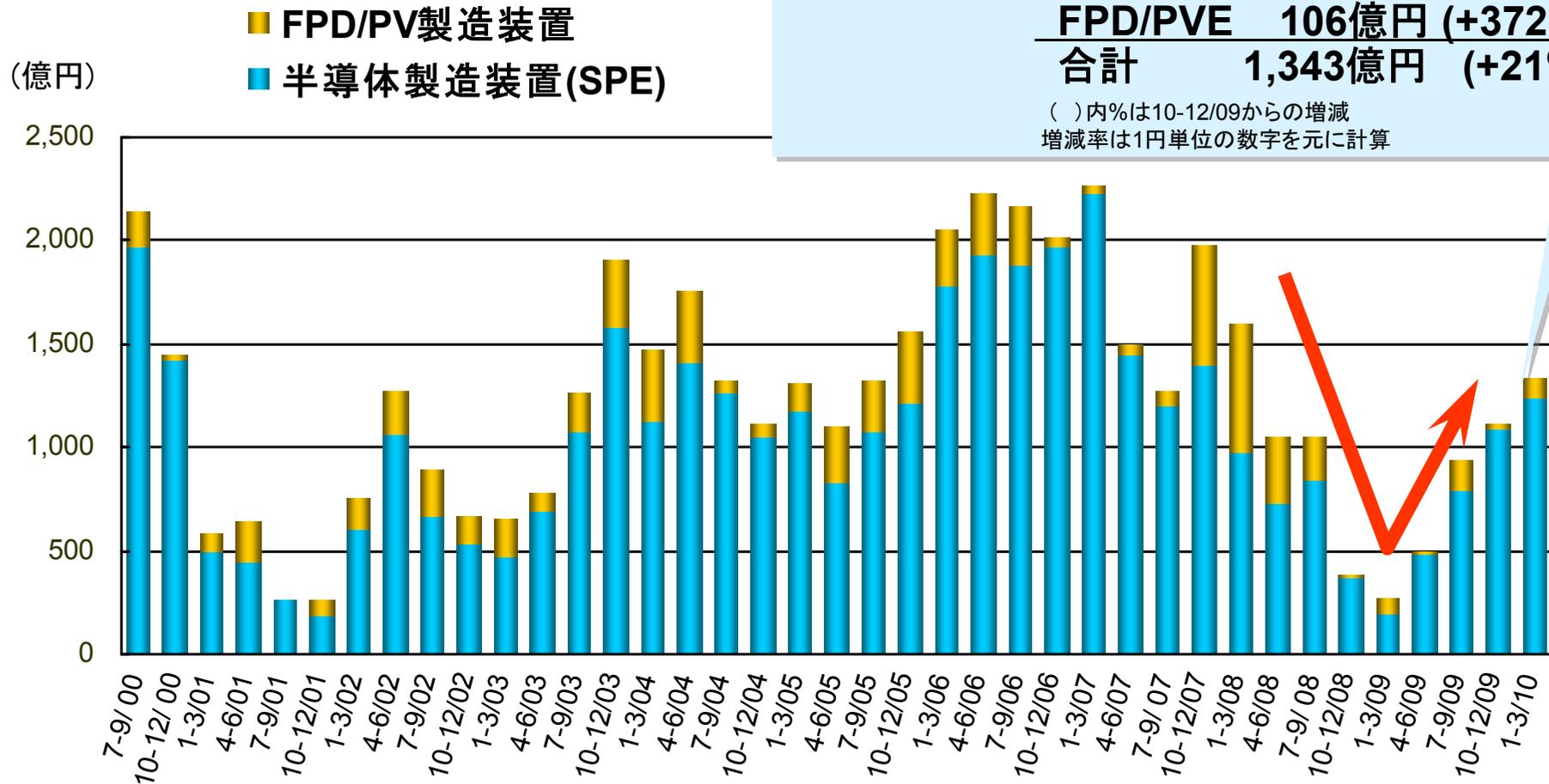


2010年/2011年の前工程投資は大きく成長

出所: Gartner DataQuest, TEL Marketing31



四半期 SPE+FPD/PVE受注額

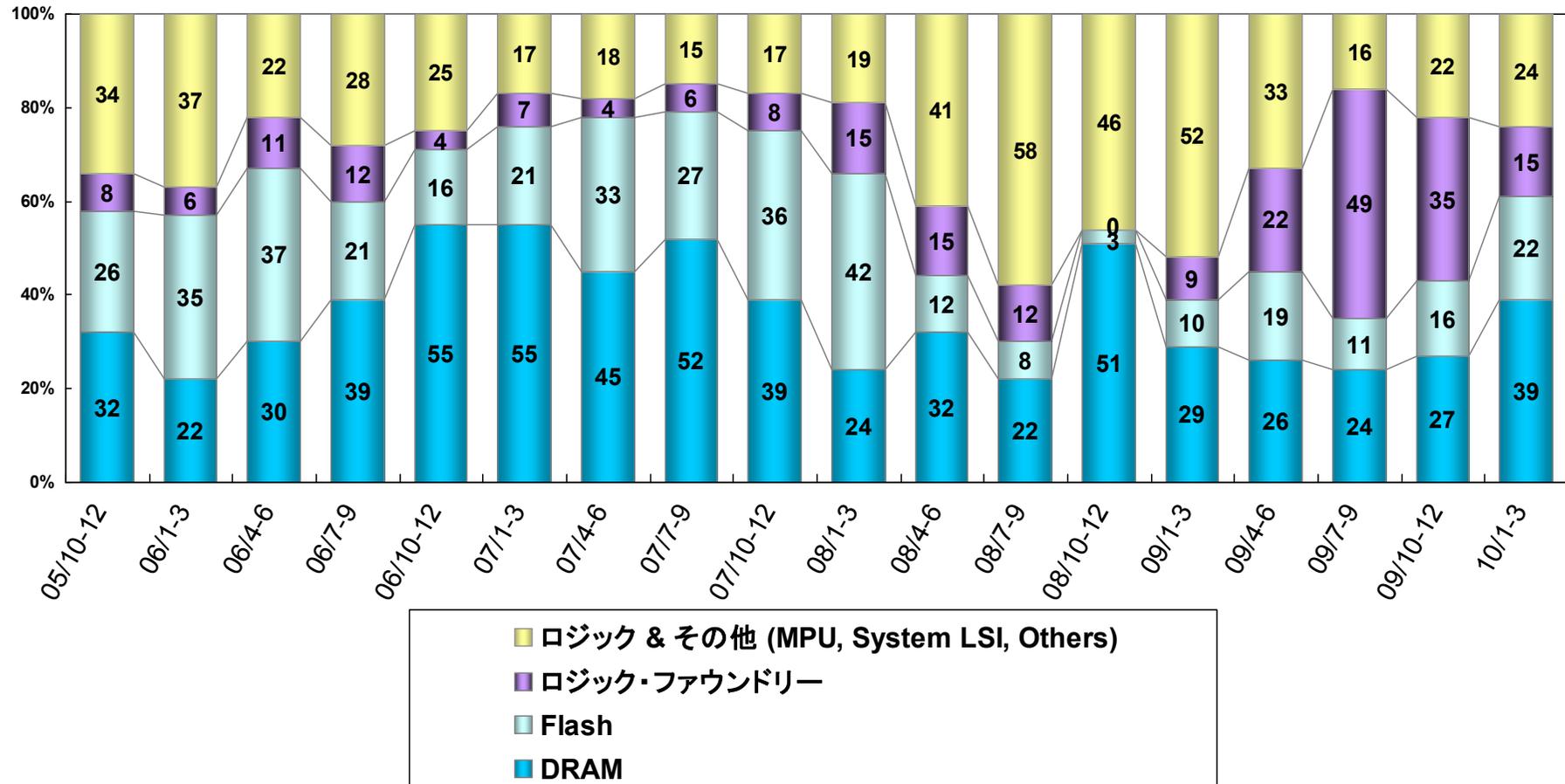


2010/1-3月期	SPE	1,236億円	(+14%)
	FPD/PVE	106億円	(+372%)
	合計	1,343億円	(+21%)

()内%は10-12/09からの増減
増減率は1円単位の数字を元に計算



四半期 アプリケーション別SPE受注



注) グラフは装置本体受注における構成比を示しています



2011年3月期 業績予想



2011年3月期 業績予想

(億円)

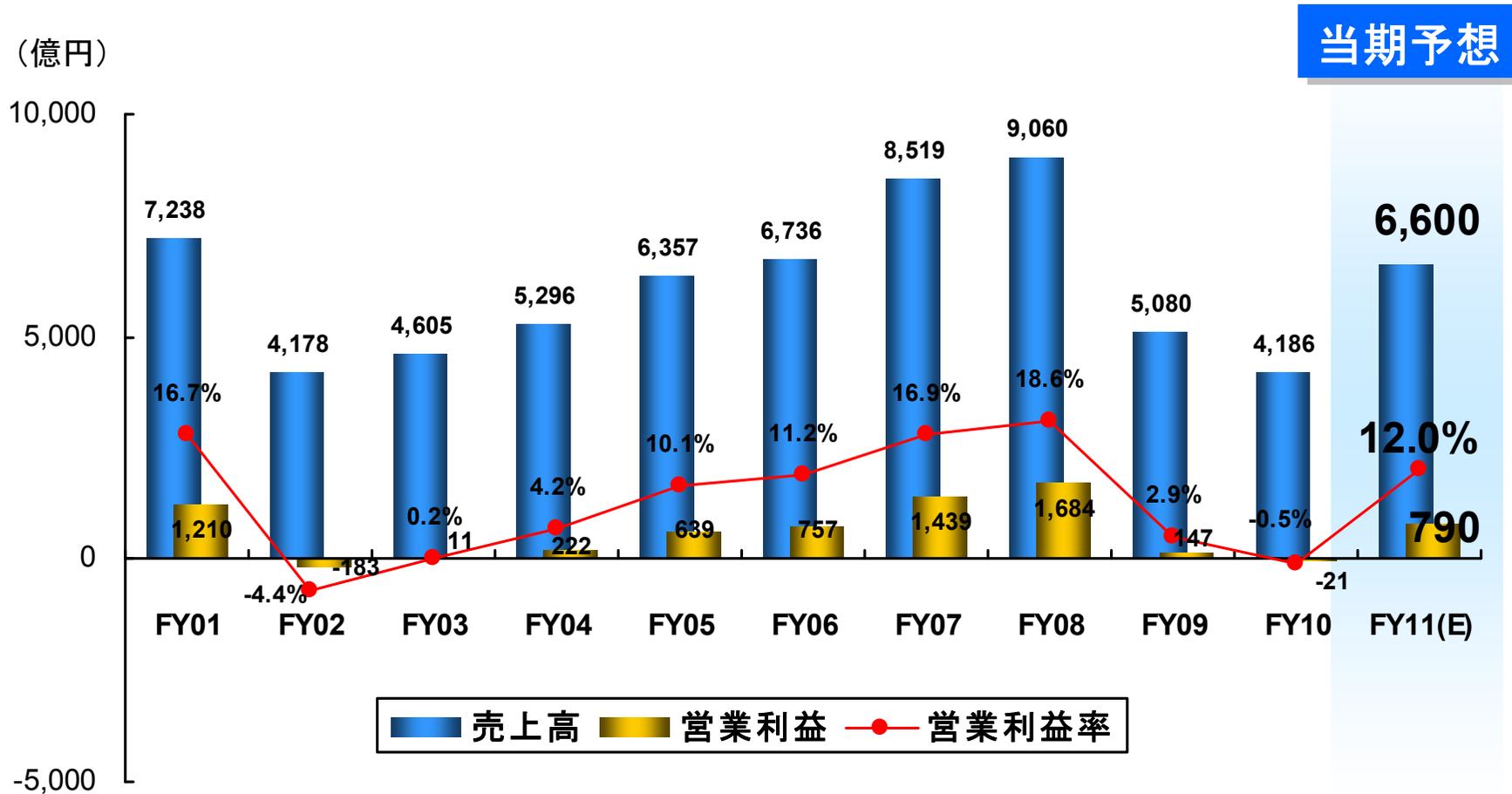
	2010年3月期		2011年3月期			
	通期		上期 (予想)	下期 (予想)	通期 (予想)	対前年 増減率/ 増減額
売上高	4,186		3,150	3,450	6,600	+58%
SPE	2,623		2,400	2,610	5,010	+91%
FPD/PVE	713		320	370	690	-3%
EC/CN	844		430	470	900	+7%
その他	3		-	-	-	-
営業利益	-21 (-0.5)		330 (10.5)	460 (13.3)	790 (12.0)	+811
経常利益	25 (0.6)		340 (10.8)	460 (13.3)	800 (12.1)	+775
税前利益	-77 (-1.9)		340 (10.8)	460 (13.3)	800 (12.1)	+877
当期純利益	-90 (-2.2)		220 (7.0)	330 (9.6)	550 (8.3)	+640
1株当り配当金 (円)	12		25	37	62	

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. ()内は利益率、単位は%
3. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



売上高・営業利益・営業利益率推移



新たな成長を目指して



基本理念

人々の健全で質の高い生活を実現する為に
先端分野に於けるトップサプライヤーとして
価値の高い技術・サービスを世界に提供

夢のある社会の構築、環境問題の対応に
一層のリーダーシップを発揮

使命感を社員全員と共有し
いきいきと輝き 夢と活力のある会社



グローバル開発・製造拠点



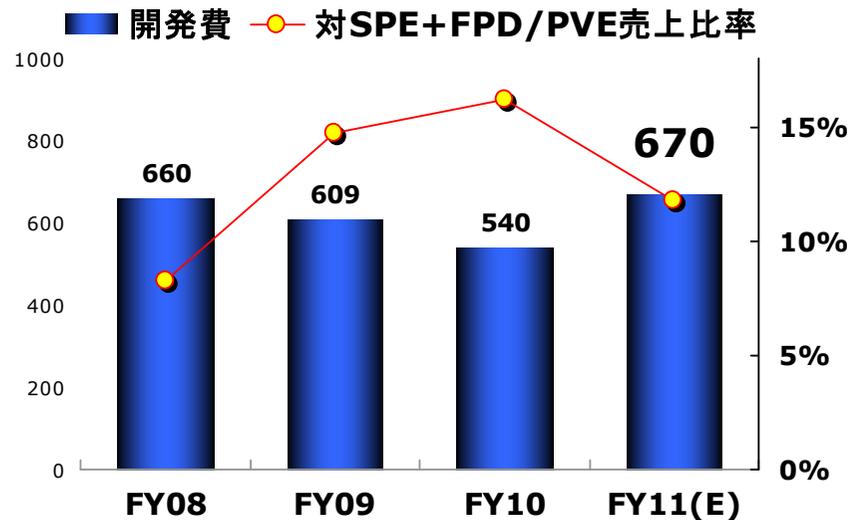
先端技術に密着した開発体制



研究開発費・設備投資計画

研究開発費

(億円)

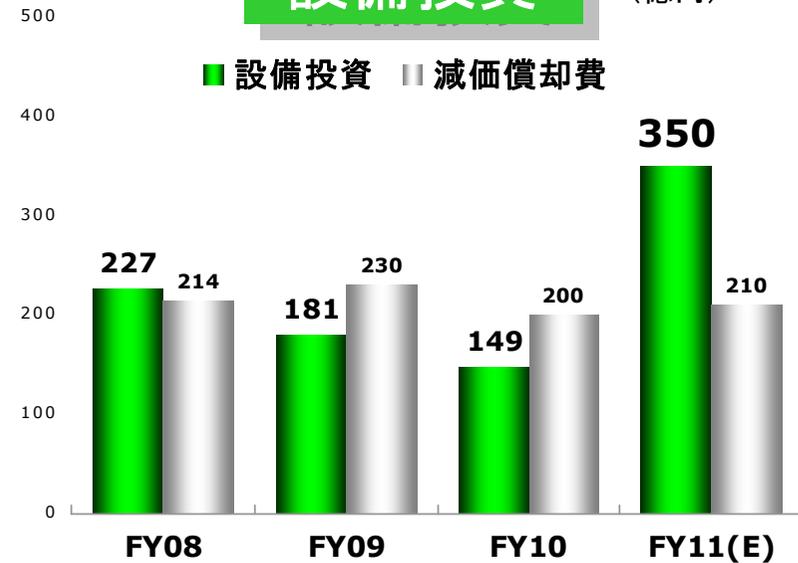


主な研究開発費

- ▶ エッチング装置(Poly Etch等)
- ▶ 枚葉洗浄装置
- ▶ RLSAアプリケーションの拡充
- ▶ 新規事業 (3DI、FPD、PV装置等)

設備投資

(億円)



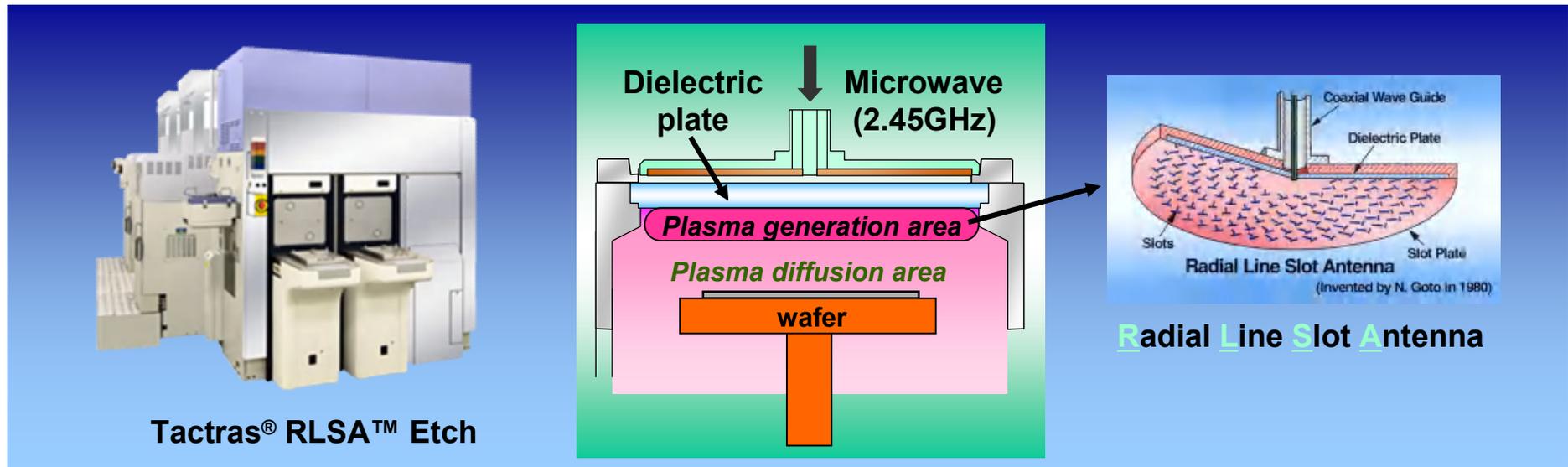
主な設備投資計画

- ▶ 宮城新工場関連
- ▶ 機械装置/測定器
- ▶ 環境関連

当期の開発投資予算は過去最大



新製品 Tactras[®] RLSA[™] Etch



RLSAの優位性

- 低ダメージ
- 高選択比



アプリケーション

- Poly Etch
- Si Etch
- CVD 等

トップメーカーでの量産採用開始



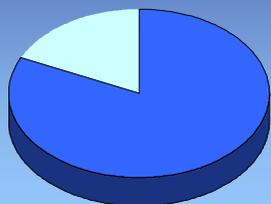
SPE事業の状況と方針

SPE事業

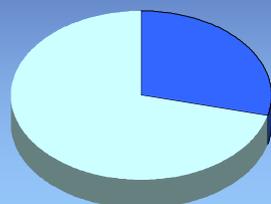
FY2010 製品シェア



コート/デベロッパ



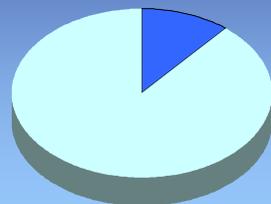
エッチャー



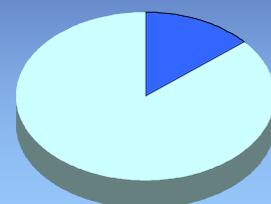
熱処理成膜



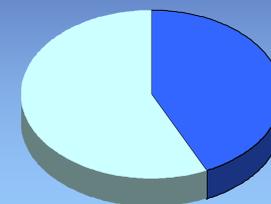
枚葉CVD



洗浄



プローバ



シェア：当社推定

Poly Etch市場でのシェア拡大
→新機種のWW展開

枚葉洗浄分野でのシェア拡大
→生産性の向上
→差別化技術を展開

特に エッチング、及び洗浄装置に注力

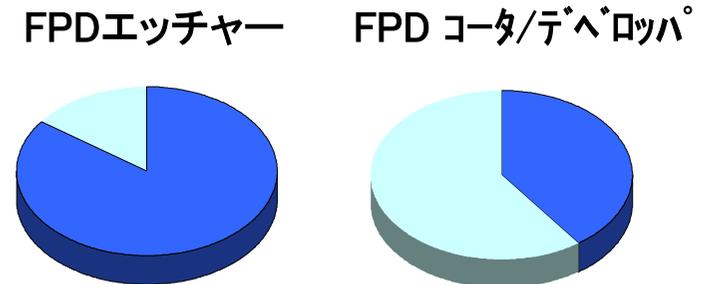


FPD/PV事業の状況と方針

FPD事業

- ▶ プロダクトポジションの拡大
- ▶ 徹底したコストダウン
- ▶ 有機ELなど新技術開発の加速

FY2010 製品シェア



シェア：当社推定

PV事業

- ▶ シャープ(株)との協業、エリコン社との提携
- ▶ 薄膜系を基軸に、長期的視野で事業の柱に育成

事業環境の変化に柔軟に対応



継続的成長のための重点施策

1. 成長余地のある既存事業の拡大
2. 差別化技術による高収益事業の構築
3. フィールド・ソリューション・ビジネスの拡大
4. 「モノづくり力」の徹底強化
5. コア技術をベースとした新規事業の開拓